



<ニュースリリース>
各 位

平成23年 5 月30日

会 社 名 大成ラミック株式会社
代 表 者 の 代表取締役社長 木 村 義 成
役 職 氏 名
(コード番号：4994 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員総務部長 千 野 博 規
電 話 番 号 0 4 8 0 - 9 7 - 0 2 2 4

海外子会社の設立と充填デモルーム開設予定のお知らせ

当社は、主力である液体小袋の海外への事業領域拡大に向けた取り組みを進めております。この度、その一環として、海外子会社を北米（シカゴ近郊）に設立するとともに、液体高速自動充填機「DANGAN」を設置し実際に充填実演が行えるデモルームを、下記のとおり開設することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 設立する子会社の概要

- (1) 商 号 : Taisei Lamick USA, Inc.
- (2) 代表者 : 山口政春（当社取締役機械・開発本部長）
- (3) 所在地 : 1801 Howard St. Unit D, Elk Grove Village, IL
- (4) 設 立 : 平成23年4月
- (5) 資本金 : 50万米ドル
- (6) 出資比率 : 当社100%
- (7) 事業内容 : 包装フィルム及び充填機械の販売

2. 今後の見通し等

当該子会社の充填デモルームは、平成23年7月に開設を予定しております。

なお、当社の業績に与える影響は軽微なものと予想しております。

以 上